

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2020-057



**深圳长城开发科技股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案**

二〇二〇年十月

发行人声明

一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

二、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

三、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需履行国有资产监管审批程序批复、公司股东大会批准以及中国证监会核准。

二、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。本次发行的股票不向公司原股东配售。

三、本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产的较高者（以下简称“发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量

如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

在上述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

四、本次发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的 6.07%，即 89,328,225 股（含本数），未超过发行前股本总数的 30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）的相关要求。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

本次非公开发行的股票数量上限以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

五、本次发行的发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

上述股份限售期结束后减持按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所现行有关规定及《公司章程》执行。

六、本次非公开发行募集资金总额不超过 171,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
存储先进封测与模组制造项目	306,726.40	171,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司解决。

七、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

八、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年

现金分红情况及未来三年分红规划等具体内容参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

九、本次非公开发行不构成重大资产重组。发行完成后不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

十、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 六、本次发行的相关风险”有关内容，注意投资风险。

目录

特别提示.....	2
目录.....	5
释义.....	7
第一节 本次非公开发行股票方案概要.....	10
一、发行人的基本情况	10
二、本次非公开发行的背景和目的	11
三、发行对象及其与公司的关系.....	14
四、本次非公开发行股票方案概要	14
五、本次发行是否构成关联交易.....	17
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	17
七、本次发行是否构成重大资产重组，是否导致公司股权分布不具备上市条件	17
八、本次发行的审批程序.....	17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....	18
一、本次非公开发行募集资金使用计划.....	18
二、募投项目情况.....	18
三、本次非公开发行对公司的影响分析.....	24
四、可行性分析结论	24
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	25
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况.....	25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	26
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	26
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	27
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	27
六、本次发行的相关风险.....	27
第四节 公司利润分配政策及执行情况.....	31
一、公司利润分配政策	31
二、公司未来三年股东回报规划.....	32

三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	39
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	40
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	40
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示	42
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性	42
四、本次非公开发行募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	42
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施	44
六、公司全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	46
七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	46

释义

本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

一、普通词汇

发行人/公司/深科技	指	深圳长城开发科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票	指	深科技非公开发行不超过 89,328,225 股（含本数）A 股普通股
本预案	指	深圳长城开发科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案
最近三年一期、报告期	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月
最近三年	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度
定价基准日	指	发行期首日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	深圳长城开发科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳长城开发科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳长城开发科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《深圳长城开发科技股份有限公司章程》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
深交所	指	深圳证券交易所
中电集团、集团、控股股东、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
沛顿科技	指	公司子公司，沛顿科技（深圳）有限公司
深科技微电子	指	公司子公司，深圳开发微电子有限公司
深科技苏州	指	公司子公司，苏州长城开发科技有限公司
深科技成都	指	公司子公司，成都长城开发科技有限公司
深科技精密	指	公司子公司，深圳长城开发精密技术有限公司

二、专业词汇

DRAM	指	Dynamic Random Access Memory 的缩写，动态随机存取存储器，最常见的系统内存
NAND Flash	指	Flash 存储的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态大容量存储的实现提供了廉价有效的解决方案
USB	指	Universal Serial BUS 的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯

SSD	指	Solid State Disk (固态硬盘), 即用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘
金士顿	指	Kingston Technology Corporation, 全球最大的独立内存产品制造商
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写, 是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件
SMT	指	Surface Mounted Technology 的简称, 意为“表面组装技术”, 是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上, 通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术
EMS	指	Electronic Manufacturing Services 的缩写, 即电子制造服务
wBGA	指	Windows-Ball Grid Array 的缩写, 一种封装技术
DDR3	指	Double-Data-Rate Three 的缩写, 一种存储器规格
DDR4	指	Double-Data-Rate Four 的缩写, 一种存储器规格
eMCP	指	Embedded Multi-Chip Package 的缩写, 即嵌入式多制层封装芯片
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写, 即代工
CAD	指	Computer Aided Design 的缩写, 即计算机辅助设计, 利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
CAM	指	Computer Aided Manufacturing 的缩写, 即计算机辅助制造
FC	指	Flip Chip 的缩写, 即倒装封装, 一种裸芯片封装技术
Bumping	指	凸点封装, 一种中道封装技术
WLCSP	指	Wafer Level Chip Size Package 的缩写, 晶圆级芯片尺寸封装
WLP	指	Wafer Level Package 的缩写, 即晶圆级封装
SIP	指	Single In-Line Package 的缩写, 即单列直插式封装
SiP	指	Single in a Package 的缩写, 即系统级封装
POP	指	Package-on-package 的缩写, 即层叠封装
TSV	指	Through-silicon Via 的缩写, 即硅通孔晶圆级芯片尺寸封装技术
BGA	指	Ball grid array 的缩写, 即球栅阵列高封装
CSP	指	Chip Scale Package 的缩写, 即芯片规模封装
IC	指	Integrate Circuit 的缩写, 即集成电路, 在一半导体基板上, 利用氧化、蚀刻、扩散等方法, 将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件, 做在一个微小面积上, 以完成某一特定逻辑功能, 达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
MEMS	指	Micro-electro-mechanical System 的缩写, 即微机电系统, 以微电子、微机械及材料科学为基础, 研究、设计、制造具有特定功能的微型装置
I/O	指	Input/Output, 即输入/输出, 通常指数据在内部存储器 and 外部存储器或其他周边设备之间的输入和输出

FBGA	指	Fine-Pitch Ball Grid Array 的缩写，即细间距球栅阵列封装，在底部有焊球的面阵引脚结构，使封装所需的安装面积接近于芯片尺寸
PGA	指	Pin Grid Array 的缩写，即插针网格阵列封装
MCM	指	Multi Chip Module 的缩写，即多芯片组件
LGA	指	Land Grid Array 的缩写，即栅格阵列封装
SOP	指	Small Out-line Package 的缩写，即带热沉小外形表面封装
TSOP	指	Thin Small Out-line Package 的缩写，即薄型小外形表面封装。引脚从封装二侧引出呈海鸥翼（L）形。在输入输出端子不超过 10-40 的领域，是普及最广的表面贴装封装，引脚中心距 1.27mm，引脚数 8-44。引脚中心距小于 1.27mm 的称为 SSOP，封装高度不到 1.27mm 的称为 TSOP
QFN	指	Quad Flat No-lead Package 的缩写，即四侧无引脚扁平封装，封装四侧有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低，引脚一般从 14 到 100
OSAT	指	Out Sourced Assembly and Testing 的缩写，即委外封装代工

注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人的基本情况

公司名称（中文）：深圳长城开发科技股份有限公司

公司名称（英文）：Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.

法定代表人：周剑

统一社会信用代码：91440300618873567Y

成立日期：1985 年 7 月 4 日

注册资本：1,471,259,363 元

住所：广东省深圳市福田区彩田路 7006 号

邮政编码：518035

投资者咨询电话：86-755-83200095

传真：86-755-83275075

电子信箱：stock@kaifa.cn

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：深科技

股票代码：000021

经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程；商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成；经营进出口业务；普通货运；房屋、设备及固定资产租赁；LED 照明产品的研发、

生产和销售，合同能源管理；节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、集成电路产业未来前景广阔

2008 年金融危机后，半导体市场逐步回升，2010-2016 年总体上保持平稳增长。根据世界半导体贸易协会（WSTS）数据显示，2017 年及 2018 年受集成电路市场的拉动，全球半导体市场销售额分别大幅增长 21.62%和 13.72%。受全球贸易动荡和产品价格周期性波动等因素的综合影响，2019 年全球半导体行业总销售额为 4,090 亿美元，较 2018 年有所下降。

根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路行业 2019 年实现销售收入为 7,562.30 亿元，同比增长 15.77%。自 2011 年以来，中国集成电路行业销售收入增速高于全球平均水平。

伴随未来先进制程的集成电路技术的进一步突破、产业周期走出调整阶段，集成电路作为信息时代皇冠上的明珠，行业前景广阔。我国半导体产业起步较晚，与海外龙头公司相比在技术制程等方面有较大差距，但凭借庞大的市场需求以及强有力的政策支持，中国逐步成为第三次集成电路产业转移承接者，未来市场潜力巨大。

2、封测产业基础稳固，高端国产替代机会涌现

我国 IC 封测行业是整个半导体产业中发展最早的子行业，规模和技术上已经与世界知名企业接轨。根据中国半导体行业协会数据，2018 年中国半导体封测市场规模 2,194 亿元，较 2017 年同比增长 16.1%，2019 年半导体封测行业销售额达到 2,350 亿元，同比增长 7.10%。2004 年至今，我国半导体封测行业一直保持高速发展，年复合增长率为 15.8%。

后摩尔时代的到来使封测企业正在向方案解决商的角色转变，封装的内容由 2D 单芯片转向 3D 多芯片，互联技术方面，也已逐步向先进封测技术（FC、Bumping、WLCSP/WLP、SiP、POP、TSV）转变，封装形式上，以 BGA、SiP、

CSP 为主。芯片测试环节是芯片产品交付终端应用的最后一道防线，越是高端的芯片对测试的依赖度越高，直接关系到最终产品的品质是否合格。过去几年，国内测试产业整体产值较小，大部分高端产品需交给我国合资或海外的测试厂完成。随着国家鼓励集成电路发展的政策措施的实施，国内的测试产业也将迎来快速发展阶段。随着 Fabless（无晶圆厂）、IDM（集成制造厂商）对 OSAT（委外封测厂）封装性能和测试能力的更高要求，先进封测厂商仍持续加大资本支出和研发投入，OSAT 封测产业的未来发展前景可期。

随着信息产业技术的发展，存储数据的安全性问题格外突出，具有自主知识产权、完全国产化的存储产品尤为重要。凭借现有的技术基础以及国家的政策支撑和研发投入，我国有望在未来先进封测技术日趋成熟的情况下成功实现国产化超越和高端国产替代。

3、集成电路业务是公司未来战略发展方向

公司作为全球领先的电子制造服务（EMS）专业提供商，在现有 EMS 核心业务基础上，通过自主创新与投资并购等方式，优化产业结构，加大力度布局集成电路封装测试等战略性新兴产业，力争实现经营业务的转型升级。

根据公司集成电路业务发展及产业布局需要，为把握国内外存储芯片发展机遇，公司积极推动自身产业链向高附加值的中上游存储芯片封装测试产业链延伸，于 2015 年全资收购金士顿旗下提供集成电路存储芯片封装与测试服务的全资子公司沛顿科技，全面提升公司核心竞争力。沛顿科技专注存储芯片封测业务 16 年以上，拥有国内先进水平的封装和测试生产线，在封测行业已有多年的生产技术积累经验。目前主要从事动态随机存储（DRAM）、闪存（Flash）芯片、嵌入式存储产品、SSD 和指纹逻辑芯片的封装和测试业务，是国内最大的 DRAM 和 Flash 存储芯片封装测试企业之一，目前主要为 wBGA、DDR3、DDR4，eMCP、USB、SSD 闪存芯片以及指纹逻辑芯片等提供封测服务，是国内唯一具有从高端 DRAM/Flash/SSD 存储芯片封测到模组、成品生产完整产业链的企业。

（二）本次非公开发行的目的

1、顺应国家集成电路产业发展战略

集成电路产业是信息技术产业的核心部分，是推动经济社会发展和信息技术产业升级的战略性和基础性产业。国家为国内集成电路产业的发展制定了多项战略规划和产业政策，大力支持集成电路产业发展。

公司集成电路业务发展顺应国家集成电路产业发展战略，按照整体战略部署，提供从芯片封测、SMT 制造、IC 组装到模组销售的“一站式”全产业链服务，助推国内存储芯片厂商加快形成涵盖存储器技术研发、产品设计、晶圆制造、芯片封装与测试、产品销售的全产业链体系，助力国家集成电路产业存储器芯片和产品全产业链条的早日实现。

随着本次募投项目的实施，有利于打破国内存储器领域对进口产品的依赖和技术壁垒，加速存储器国产化替代进程，提升国产存储器芯片的产业规模，促进我国存储器产业链发展。

2、保持公司行业领先地位，增强公司综合实力

公司全资子公司沛顿科技专注存储芯片封测业务 16 年以上，拥有国际先进水平的封装和测试生产线，在封测行业已有多年的生产技术积累经验，占据国内 DRAM 出货量约 20% 的份额，是国内最大的 DRAM 和 Flash 存储芯片封装测试企业之一。公司产品技术、制造工艺与世界先进水平同步。

本次非公开发行募集的资金将全部用于“存储先进封测与模组制造项目”，为客户提供存储芯片封测和模组制造产能。随着本次募投项目的实施，公司将进一步提升产能，扩大市场份额，全面提升公司核心竞争力，满足快速增长的市场需求，为公司顺利开拓市场奠定坚实基础。

3、优化资本结构，提升资产质量和盈利能力

为保持公司在存储芯片封测领域的领先优势、顺利开拓市场，公司需要进一步提升产能，扩大市场份额。本次非公开发行募集资金可以缓解公司的资金压力，改善公司的资产负债比例。本次募投项目投产后，公司将更加高效地服务于客户，产生良好的经济效益，提升上市公司的资产质量和盈利能力，实现国有资产的进

一步保值增值。

三、发行对象及其与公司的关系

（一）发行对象

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。最终具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）发行对象与公司的关系

截至本预案公告日，本次发行的发行对象尚未确定，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

四、本次非公开发行股票方案概要

（一）发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式进行，在本次发行获得中国证监会核准后，公司将在核准批复的有效期限内选择适当时机实施。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其

授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。本次发行的股票不向公司原股东配售。

（四）发行价格及定价原则

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80% 与本次发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产的较高者（以下简称“发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量

如在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。

在上述发行底价的基础上，最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

（五）发行数量

本次发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的 6.07%，即 89,328,225 股（含本数），未超过发行前股本总数的 30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）的相关要求。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

本次非公开发行的股票数量上限以中国证监会最终核准发行的股票数量为

准。

（六）限售期

本次发行的发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

上述股份限售期结束后减持按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所现行有关规定及《公司章程》执行。

（七）募集资金总额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 171,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
存储先进封测与模组制造项目	306,726.40	171,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（八）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

（九）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（十）决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。截至本预案公告日，尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司总股本为 1,471,259,363 股，其中，中电集团持有公司 538,558,777 股股票，占发行前公司股本的 36.61%，是公司控股股东和实际控制人，国务院国资委为公司的最终控制人。

按照本次非公开发行股票数量上限 89,328,225 股测算，本次发行完成后，中电集团将持有公司 34.51% 的股份，仍为公司控股股东和实际控制人，国务院国资委仍为公司的最终控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否构成重大资产重组，是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次非公开发行不构成重大资产重组。本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于 10%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。

八、本次发行的审批程序

2020 年 10 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过深科技 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

本次非公开发行股票相关事项尚需履行国有资产监管审批程序批复、公司股东大会批准以及中国证监会核准。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 171,000.00 万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
存储先进封测与模组制造项目	306,726.40	171,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募投项目情况

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：存储先进封测与模组制造项目
- 2、项目建设单位：合肥沛顿存储科技有限公司（暂定，以工商登记机关登记为准）
- 3、建设地点：合肥空港经济示范区集成电路产业园
- 4、项目性质：新建
- 5、主要产品：存储芯片封测和模组
- 6、项目总投资：项目总投资 306,726.40 万元，其中建设投资 296,471.17 万元，铺底流动资金 10,255.23 万元
- 7、项目建设周期：36 个月
- 8、主要建设内容：
 - （1）DRAM 存储芯片封装测试业务，计划全部达产后月均产能为 4,800 万颗

(2) 存储模组业务，计划全部达产后月均产能为 246 万条模组

(3) NAND Flash 存储芯片封装业务，计划全部达产后月均产能为 320 万颗

(二) 项目实施的必要性

1、顺应国家集成电路产业发展战略

集成电路产业是信息技术产业的核心部分，是推动经济社会发展和信息技术产业升级的战略性和基础性产业。国家为国内集成电路产业的发展制定了多项战略规划和产业政策，大力支持集成电路产业发展。

公司集成电路业务发展顺应国家集成电路产业发展战略，按照整体战略部署，提供从芯片封测、SMT 制造、IC 组装到模组销售的“一站式”全产业链服务，助推国内存储芯片厂商加快形成涵盖存储器技术研发、产品设计、晶圆制造、芯片封装与测试、产品销售的全产业链体系，助力国家集成电路产业存储器芯片和产品全产业链条的早日实现。

随着本次募投项目的实施，有利于打破国内存储器领域对进口产品的依赖和技术壁垒，加速存储器国产化替代进程，提升国产存储器芯片的产业规模，促进我国存储器产业链发展。

2、助力国内存储器芯片封测的国产化

本项目实施后，可满足客户较大需求的 DRAM、Flash 存储芯片封测以及 DRAM 内存模组制造业务，有助于国内存储器芯片封测的深度国产化。公司根据客户整体产能建设的需要，契合客户业务布局，对公司建立长期稳定的客户关系起到积极作用。客户产能的逐步提升将直接带动公司集成电路封测业务的订单增加。本次募投项目实施后的新增产能加上公司现有产能，将为存储器芯片国产化提供保障。

3、满足国内集成电路产业快速发展的市场需求

随着汽车电子、信息安全、区块链、5G 通讯、物联网、MEMS 传感器等新兴领域的发展，中国集成电路市场始终保持稳步增长的态势。根据中国半导体行业协会，2019 年中国集成电路总销售额达到了 7,562.30 亿元，同比增长 15.77%，

其中集成电路封装测试行业销售额达到 2,349.70 亿元，同比增长 7.10%。虽然目前封装测试收入的增速略低于集成电路产业整体的增长水平，但近年来愈来愈多的芯片封测需求转向国内市场，国内的封测市场规模一直保持稳定增长的趋势。

按照目前集成电路行业的整体销售增长预期和行业战略规划，国内封测行业作为集成电路产业链的重要环节依旧具备广阔的成长空间。本项目通过增加先进封测设备来扩大公司芯片封测产能，可突破现有产能的限制，满足快速增长的市场需求，为公司顺利开拓市场奠定坚实基础。

4、提升公司核心竞争力，实现业务战略转型升级

公司作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，在现有 EMS 核心业务基础上，通过自主创新与投资并购等方式，优化产业结构，加大力度布局集成电路封装测试等战略性新兴产业，力争实现经营业务的稳步增长。本项目是公司实现业务转型升级、实现公司发展战略的重大项目。本项目实施后，公司在集成电路业务的收入和净利润将得到大幅提升，市场份额明显扩大，有助于提升公司核心竞争力，实现业务战略转型升级。

5、加快公司集成电路芯片封测技术升级

先进封测是未来封测行业的主要发展方向，是提升芯片效能的增量动力。在先进封测技术方面，与全球一流企业相比，国内封测企业虽然已经取得长足进步，但是综合技术水平还有相当的差距。

围绕更多的 I/O、更薄的厚度，以承载更多复杂的芯片功能和适应更轻薄的移动设备演进，未来 DDR5 内存生产需要采用 FC（倒装）和 TSV（硅穿孔技术）技术，先进封装将是未来封测行业的主要发展方向，通过本次募投项目的实施，沛顿科技可以提升自身先进封测综合实力，在先进封测领域取得突破性进步。

沛顿科技封装技术包括 wBGA/FBGA 等，具备先进封装 FlipChip/TSV 技术（DDR4 封装）能力。本项目以发展为主题，以科技创新为动力，在提升和扩大封装测试产能规模与水平的同时，为公司发展 FC、TSV、WLP 等高端封装技术，形成满足市场需求规模的生产能力提供了宝贵的发展机遇，有助于降低研发成

本，缩短研发周期，提升核心业务的技术含量与市场附加值，为公司未来的可持续发展提供有利支撑。

（三）项目实施的可行性

1、国家产业政策为项目建设保驾护航

集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、自动化、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。近十年来，我国政府主导大力发展集成电路产业，国家和地方关于促进集成电路发展的政策频出，涉及产业发展目标、企业优惠政策、人才培养政策等多个领域。根据 2014 年 6 月颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》，到 2020 年中国集成电路全行业销售收入年均增速将超过 20%。2016 年，我国集成电路产业“十三五”发展规划建议提出，到 2020 年我国集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，同时实现封装测试技术进入全球第一梯队、关键装备和材料进入国际采购体系、基本建成技术先进且安全可靠的集成电路产业体系等目标。

2020 年 7 月 27 日，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量提供了有利的政策保障。

根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类：“二十八、信息产业，19、集成电路设计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试”的范畴，符合国家产业政策。同时，本项目为合肥市地方产业规划中重点发展的项目，符合《安徽省半导体产业发展规划（2018—2021 年）》和《关于印发合肥市加快推进软件产业和集成电路产业发展的若干政策实施细则（集成电路产业）的通知》的要求。

受益于国家及地方政府对集成电路产业的大力支持，并且在我国工业化和信息化融合持续深入、信息消费不断升温、智慧城市建设加速等多方因素的协同带

动下，预计国内整个集成电路产业链依旧会保持增长的态势，这一趋势不仅仅是受到经济驱动，更是国家政策引导的大方向。因此，本项目的实施系国家政策的鼎力支持，有利于公司加快国内市场布局的步伐，占据更有竞争力的市场地位。

2、公司现有技术储备为项目提供技术保障

本项目技术来源于沛顿科技自主研发与长期积累，沛顿科技存储芯片封装制程采用的是当前高端产品的主流技术，如 wBGA、LGA、SOP、TSOP、QFN、系统级 SiP 封装技术等，现有产品已实现多达 16 层的多晶堆叠技术，最大单颗芯片容量可达到 256G。

沛顿科技具备 DDR4 封装和测试技术，采用的 BGA、LGA 等封装技术优势明显，产品合格率高，交货周期快，产品质量稳定，领先于国内其他竞争对手；沛顿科技的日本研发团队开发测试方案和程式，提供定制化服务的支持，技术工艺竞争优势明显。

公司强大的技术实力，可实现对客户不断变化的需求做出快速反应，在技术水平和综合效率方面始终处于行业领先地位，为本项目的实施提供了重要的技术保障。

3、公司具备经验丰富的管理、技术和生产人员为项目提供可靠的人力资源保障

集成电路先进封测对生产管理、技术积累与人才要求较高，需要丰富的经验积累，才能保证产品的质量和对新产品的响应速度。同时，封测设备与芯片的质量紧密相连，随着芯片产业的不断深入发展，对半导体封测设备的要求也越来越严苛，需要高素质的专业技术人员和完善的管理制度，实现硬件、软件的有机结合，保证封测业务的质量及效率。

公司业务覆盖全球多个国家和地区，作为业务国际化的上市企业，公司已组建了具有国际化视野的高管团队和培养了经验丰富的生产管理人员及技术骨干，总结和开发了一套较为完善的人才管理及培养体系，为公司发展培育专业素质高、满足公司未来发展需求的储备人才，为项目的实施提供了有效的人力资源保障。

4、公司稳定优质的客户资源为项目产能消化提供保障

公司致力于为全球行业一流客户提供综合服务，集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供满足重点客户要求和市场发展需求的产品和服务，不断提升技术创新水平，加快发展步伐，建立双赢的战略合作关系，扩大产品市场占有率。通过本次募投项目的实施，将进一步推动公司向产业链高附加值的中上游存储芯片封装测试部分延伸，向核心技术领域的产业转型升级，提升综合服务客户的能力，巩固和提升已建立的战略合作伙伴关系。

本项目根据客户整体产能建设的需要，较好地契合客户业务布局，随着客户产能逐渐释放，将直接带动公司在集成电路封测业务订单的增加，为项目产能消化提供保障。

（四）项目投资估算

本项目总投资 306,726.40 万元，其中建设投资 296,471.17 万元，铺底流动资金 10,255.23 万元；拟使用非公开发行募集资金 171,000.00 万元，全部用于建设投资（根据建设进度），包括基础建设和设备购置，不足部分将利用自筹资金解决，投资概算如下：

单位：万元

序号	费用名称	投资金额	占总投资比例	计划使用募集资金
一	建设投资	296,471.17	96.66%	171,000.00
1	设备购置	221,201.93	72.12%	
2	基础建设	75,269.25	24.54%	
2.1	FAC 装修	14,439.50	4.71%	
2.2	FAC 动力设施	21,989.75	7.17%	
2.3	建筑工程(含土地费用)	38,840.00	12.66%	
二	铺底流动资金	10,255.23	3.34%	-
	项目总投资	306,726.40	100.00%	171,000.00

（五）项目经济效益测算

项目全面达产后，预计可实现年产值 286,291.50 万元，项目税后内部收益率为 15.22%，投资税后静态投资回收期为 7.59 年。

（六）项目报批事项

截至本预案公告日，本项目相关的备案、环评批复正在办理过程中。

三、本次非公开发行对公司的影响分析

（一）本次发行对公司经营管理的影响

通过本次非公开发行，公司的资本实力与生产规模将进一步提升，产品结构将得到优化，高端服务或产品占比大幅提升。本次非公开发行将有利于公司巩固行业领先地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资金实力将得到有效提升，资产负债率将有所下降，流动比率及速动比率将有所上升，有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，并为公司后续融资提供良好的保障。长远来看，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益短期内无法体现，可能存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄等情况。随着募投项目产生效益，公司的收入和净利润将会增加，净资产收益率和每股收益等指标会有所提高。

四、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目主要围绕公司战略发展方向展开，符合国家有关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，能够进一步提升公司的行业领先地位和抗风险能力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。因此，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东利益。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况

（一）本次发行后公司业务及资产变化情况

公司本次发行募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开。项目实施后，公司将进一步增强在存储芯片封装测试及模组制造领域的生产能力，助推公司实现战略升级、纵向一体化的业务布局，优化产品结构，巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，增强公司主营业务盈利能力，促进公司的长期可持续发展。本次发行不会对公司主营业务和经营产生重大变化。募投项目投资建设完成后，公司固定资产规模将相应扩大。

（二）本次发行后公司章程变化情况

本次发行完成后，公司股东结构和注册资本将发生变化，公司将根据发行结果对公司章程中的相应条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）本次发行后对股东结构变化情况

截至本预案公告日，公司总股本为 1,471,259,363 股，其中，中电集团持有公司 538,558,777 股股票，占发行前公司股本的 36.61%，是公司控股股东和实际控制人，国务院国资委为公司的最终控制人。

按照本次非公开发行股票数量 89,328,225 股测算，本次发行完成后，中电集团将持有公司 34.51% 的股份，仍为公司控股股东和实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（四）本次发行后高级管理人员变化情况

截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行后公司业务收入结构变化情况

本次发行前，公司主营业务为电子产品先进制造，包括集成电路业务、高端

制造服务和自主品牌业务等。本次非公开发行募集资金投资项目建设完成后，公司将扩大集成电路业务的销售规模，主营业务产品类别不会发生重大变化，收入结构可能会有所调整。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资产总额与净资产总额将同时增加，资金实力将得到有效提升，资产负债率将有所下降，流动比率及速动比率将有所上升，有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，并为公司后续融资提供良好的保障。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，随着本次募集资金投资项目投产，公司的营业收入和净利润水平不断提升，为公司后续发展提供有力支持，增强公司的可持续发展能力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法体现，可能存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄等情况。随着募投项目产生效益，公司的收入和净利润将会增加，净资产收益率和每股收益等指标会有所提高。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司本年度筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将得以提升。随着募集资金投资项目的实施和效益的产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将有所增加，公司的总体现金流量将有所改善。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所降低，资产负债结构将更趋稳健，抵御风险能力将进一步增强。公司不存在通过本次发行增加大额负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

六、本次发行的相关风险

（一）宏观经济环境变化风险

本次发行前，公司主营业务为电子产品先进制造，业务下游涉及计算机、消费电子、通信设备、医疗产品、计量产品等各类型电子产品。电子产品的需求变化受全球及国内宏观经济运行情况影响较大，经济发展的周期性特征决定公司主要产品的市场需求也会具有相关的周期性。宏观经济环境运行情况对公司所在行业以及公司的发展会产生较为深远的影响，从而可能影响公司发展战略及经营目标的实现。

（二）行业竞争的风险

公司主营业务涉及的行业发展基本处于成熟阶段，行业门槛较高，短期内难以出现具备较强竞争力的新企业，行业竞争集中于大型制造企业之间。经过多年发展，公司各业务在行业中已经建立了行业地位，拥有较为先进的技术水平，具有较大的规模优势，与客户、供应商建立了稳定的合作关系，拥有较强的竞争优势，但仍然存在市场竞争加剧影响公司业绩的风险。

（三）募集资金投资项目未能实现预期效益风险

本次非公开发行募集资金将用于“存储先进封测和模组制造项目”的建设。在项目实施过程中，可能存在因政府规划调整、意外事故或其他不可抗力因素，造成项目不能按期建设、项目达产延迟等不确定情况，最终导致募投项目投资周期

延长、投资超支、投产延迟，未能实现预期效益的风险。此外，项目建设投产后，存在因技术发展、市场需求变化、新产品替代及客户自身原因等因素导致市场需求减少、产品价格下滑，导致项目未能实现预期效益的风险。

（四）产业政策变化风险

集成电路行业作为信息技术产业的支柱产业之一，是支撑信息技术产业发展，促进经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。我国政府高度重视发展集成电路产业，制定并实施了一系列的产业支持政策，如《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《国家集成电路产业发展推进纲要》《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》《关于〈鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题〉的通知》等。政府对集成电路行业的产业政策为企业提供了良好的政策环境，并吸引了相关产业基金对行业企业的资金支持。如国家产业政策发生不利变化，将对行业及企业产生一定的影响。

（五）业务与经营风险

1、管理风险

本次非公开发行完成后，公司总资产及净资产规模将增加，经营业务也将进一步提升。公司已建立了严格的公司内部治理体系和较为完善的管理制度，经营管理良好，但随着募集资金的到位，公司经营决策、人员管理和风险控制的难度将有所增加，对公司管理层的管理水平也提出了更高的要求。如果公司未能建立适应资产规模扩大后的运营管理模式，将直接影响公司的发展速度以及本次非公开发行的实际效益。

2、环保和安全生产风险

公司在研发和生产过程中会产生废气、废水、废渣或其他污染物。公司一直高度重视环境保护和安全生产工作，建立了一系列管理制度，报告期内公司未发生重大安全生产事故和环保事故。但是，公司依然存在因人为操作不当、设备故障、工艺操作不当等事件所导致的安全、环保事故的风险。

3、人力资源不足风险

集成电路行业属于技术密集型和人才密集型产业，人力资源是企业的核心竞

争力之一。为了公司发展需要以及应对市场竞争，需要不断吸引优秀人才的加盟以及储备和培养各类技术人才。同时，随着行业竞争日益激烈，公司人员存在一定的流失风险。虽然公司已建立较为完善的薪酬福利体系和人才培养体系，但存在核心管理人员和技术人才流失或者因规模扩张导致人力资源不足的风险，影响公司经营业绩。

（六）财务风险

1、应收账款回收风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 241,847.22 万元，占当期期末资产总额的比重为 11.71%。报告期内，公司应收账款规模处于合理水平，应收账款周转正常，主要客户信用较高，未发生过逾期恶意拖欠款项情形。但依然存在因客户经营不善、突发意外事件或不可抗力因素导致无法按时支付货款，形成坏账的风险，从而对公司资金周转及经营业绩产生不利影响。

2、存货跌价风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存货账面价值为 242,158.46 万元，占当期期末资产总额的比重为 11.73%。公司业务主要根据客户订单安排生产，公司高度重视采购、生产、销售的安排和存货管理。一方面，根据订单情况，安排和制定合适的生产计划，以加快半成品和产成品的周转速度，降低存货跌价风险；另一方面，加强存货管理，减少存货毁损变质情况发生。报告期内，公司已经按照企业会计准则要求，根据存货实际情况计提存货跌价准备。但存在受市场影响，产品销售价格下跌导致存货发生跌价的风险，从而影响公司业绩。

3、汇率变动风险

最近三年，公司主营业务收入大部分来自中国（含香港）以外地区，实现汇兑收益分别为 5,308.98 万元、25,518.86 万元和 28,326.70 万元。公司已采取利率互换、远期结售汇等套期保值常规方式，降低汇率波动风险。但汇率变动受各地区经济发展情况、国家和地区中央银行货币政策、国际货币市场交易情况等因素影响，汇率变动可能对公司业绩产生一定影响。

4、国家税收优惠及政府补贴政策变化风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司、深科技微电子、沛顿科技、深科技苏州、深科技成都、深科技精密已取得《高新技术企业证书》，适用 15% 的企业所得税税率。此外，公司及子公司每年也收到一定的政府补贴。如果公司或子公司将来不能继续被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策、财政补贴政策发生变动，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

（七）审批风险

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括取得主管国有资产管理部門的批复、公司股东大会批准以及中国证监会核准等，能否获得相关的批复、批准或核准，以及获得时间均存在不确定性。

（八）股价波动风险

股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。同时，公司本次非公开发行尚需履行多项审批程序，需要一定的时间周期方能完成，在此期间，公司股票的市场价格可能会出现波动，直接或间接对投资者造成损失，投资者在考虑投资本公司股票时，应预计前述因素可能带来的投资风险，并做出审慎的判断。

（九）新冠疫情影响风险

2020 年初爆发的新型冠状病毒疫情对全球社会经济造成了较大影响。经过公司积极应对和防疫安排，疫情情况对公司 2020 年上半年业绩影响较小。但目前新冠疫情尚未完全消除，如疫情未能得到有效控制，预计将会对全球宏观经济和消费市场产生较大影响，进而影响相关行业及产业链上游企业，有可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。

第四节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

根据《公司章程》第一百八十六条，公司利润分配政策如下：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下，应积极推行现金分配方式。

（三）公司原则上每年至少分红一次，董事会可以根据公司经营实际情况提议公司中期分红。

（四）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

在保证公司最低现金分红和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，公司可以另采取股票股利分配方式进行利润分配。公司发放股票股利进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。

（五）具体利润分配预案由董事会拟定，独立董事应当发表明确的独立意见，并提交股东大会进行审议。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。

公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的, 应当在定期报告中披露未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见; 公司在召开股东大会时除现场会议外, 还应向股东提供网络形式的投票平台。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

(七) 公司调整利润分配政策, 应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证, 并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过, 独立董事应当发表明确的独立意见。

(八) 公司应通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、互动平台等)充分听取独立董事以及股东特别是中小股东的意见, 做好利润分配事项的信息披露。

二、公司未来三年股东回报规划

(一)《深圳长城开发科技股份有限公司股东回报规划(2018-2020年)》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等相关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《深圳长城开发科技股份有限公司股东回报规划(2018-2020年)》(以下简称“规划(2018-2020年)”)。规划(2018-2020年)已经公司2018年4月10日第八届董事会第十七次会议、2018年5月9日第二十六次(2017年度)股东大会审议批准。具体内容如下：

“（一）制定股东回报规划考虑因素

公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展规划、现金流量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，对公司利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。

（二）股东回报规划制定原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

（三）利润分配形式

1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远的可持续发展的原则，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下，应积极推行现金分配方式。

（四）利润分配时间间隔

在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年度至少分红一次，董事会可以根据公司经营实际情况提议公司进行中期分红。

（五）利润分配条件

1、现金分红条件

（1）当年每股收益不低于0.1元人民币。

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的

50%且超过 5000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、发放股票股利的条件

(1) 公司可以根据年度盈利、累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重资本扩张，公司可以另采取股票股利分配方式进行利润分配。公司发放股票股利进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。

(2) 当公司以法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(六) 分红比例

1、公司应保持利润分配政策的持续性与稳定性，在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如果三年内公司净利润保持高速增长，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。

2、公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

4、存在股东违规占用公司资金情形的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(七) 利润分配的决策程序和相关机制

1、利润分配预案

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

具体利润分配预案由董事会拟定, 独立董事应当发表明确的独立意见, 并提交股东大会进行审议。公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司应提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。

公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的, 应当在定期报告中披露未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见, 公司在召开股东大会时除现场会议外, 还应向股东提供网络形式的投票平台。

2、利润分配政策及股东回报规划制定周期及调整

(1) 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况, 结合独立董事、监事及所有股东的意见制定股东分红回报规划, 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划, 以对正在实施的利润分配政策和股东回报规划作出适当且必要的调整。

(2) 当公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划和长期发展目标等发生重大变化, 公司可以对利润分配政策和股东分红回报规划进行调整, 并应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证, 由董事会提交股东大会以特别决议审议通过, 独立董事应当发表明确的独立意见。

(八) 其他

1、公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者决策。

2、公司股东回报规划及相应的《公司章程》修订案需经公司股东大会批准后实施。”

（二）《深圳长城开发科技股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》

为完善和健全深圳长城开发科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2013〕43 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定公司股东回报规划（2021-2023 年）（以下简称“规划（2021-2023 年）”）。规划（2021-2023 年）已经公司 2020 年 10 月 16 日第九届董事会第九次会议审议通过，尚需得到股东大会审议批准。具体内容如下：

“一、制定股东回报规划考虑因素

公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展规划、现金流量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，对公司利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。

二、股东回报规划制定原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

三、利润分配形式

1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远的可持续发展的原则，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下，应积极推行现金分配方式。

四、利润分配时间间隔

在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年度至少分红一次，董事会可以根据公司经营实际情况提议公司进行中期分红。

五、利润分配条件

1、现金分红条件

(1) 当年每股收益不低于 0.1 元人民币。

(2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)，重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 5000 万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、发放股票股利的条件

(1) 公司可以根据年度盈利、累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重资本扩张，公司可以另采取股票股利分配方式进行利润分配。公司发放股票股利进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。

(2) 当公司以法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

六、分红比例

1、公司应保持利润分配政策的持续性与稳定性，在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如果三年内公司净利润保持高速增长，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。

2、公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。

3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

4、存在股东违规占用公司资金情形的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

七、利润分配的决策程序和相关机制

1、利润分配预案

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

具体利润分配预案由董事会拟定，独立董事应当发表明确的独立意见，并提交股东大会进行审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司应提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

2、利润分配政策及股东回报规划制定周期及调整

(1) 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事及所有股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，以对正在实施的利润分配政策和股东回报规划作出适当且必要的调整。

(2) 当公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划和长期发展目标等发生重大变化，公司可以对利润分配政策和股东分红回报规划进行调整，并应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见。

八、其他

公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者决策。

“公司股东回报规划及相应的《公司章程》修订案需经公司股东大会批准后实施。”

三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

(一) 公司最近三年利润分配情况

最近三年，公司现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
现金分红额（含税）	8,827.56	14,712.59	7,356.30
归属于母公司所有者的净利润	35,230.12	53,007.32	54,130.30
现金分红/当期归属于母公司所有者的净利润	25.06%	27.76%	13.59%

(二) 公司最近三年未分配利润使用情况

最近三年公司实现的归属于上市公司股东的净利润在向股东分配后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。

第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一) 主要假设

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行于 2020 年 11 月 30 日实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证券监督管理委员会核准并实际发行完成时间为准；

3、公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 35,230.12 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 15,874.74 万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上一年度保持持平、增长 10%或增长 25%。该假设仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

4、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素所导致的股本变化。截至本次非公开发行预案公告日，上市公司总股本为 1,471,259,363 股。假设按照本次非公开发行股票数量上限 89,328,225 股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将达到 1,560,587,588 股；

5、假设本次非公开发行募集资金总额为 171,000.00 万元，不考虑发行费用，本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

6、除用于募集资金投资项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公

司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；

7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；

8、未考虑本次非公开发行预案公告日至本次发行完成日期间公司公告分红方案的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	1,471,259,363	1,471,259,363	1,560,587,588
情景1：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%			
归属于母公司所有者的净利润（元）	352,301,166.89	352,301,166.89	352,301,166.89
扣非后归属于母公司所有者的净利润（元）	158,747,432.86	158,747,432.86	158,747,432.86
基本每股收益（元/股）	0.24	0.239	0.238
基本每股收益（扣非后，元/股）	0.11	0.108	0.107
加权平均净资产收益率（%）	5.19	4.99	4.90
情景2：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%			
归属于母公司所有者的净利润（元）	352,301,166.89	387,531,283.58	387,531,283.58
扣非后归属于母公司所有者的净利润（元）	158,747,432.86	174,622,176.15	174,622,176.15
基本每股收益（元/股）	0.24	0.263	0.262
基本每股收益（扣非后，元/股）	0.11	0.119	0.118
加权平均净资产收益率（%）	5.19	5.48	5.37
情景3：2020年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为25%			
归属于母公司所有者的净利润（元）	352,301,166.89	440,376,458.61	440,376,458.61
扣非后归属于母公司所有者的净利润（元）	158,747,432.86	198,434,291.08	198,434,291.08
基本每股收益（元/股）	0.24	0.299	0.298

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
基本每股收益（扣非后，元/股）	0.11	0.135	0.134
加权平均净资产收益率（%）	5.19	6.20	6.09

注：基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次非公开发行股票的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 171,000.00 万元，拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
存储先进封测与模组制造项目	306,726.40	171,000.00

本次发行的必要性和合理性参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

四、本次非公开发行募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

本次发行前，公司主营业务为电子产品先进制造，包括集成电路业务、高端制造服务和自主品牌业务等。集成电路业务主要为存储芯片封装测试与模组制造。本次非公开发行募集资金用于“存储先进封测和模组制造项目”的建设，项目主要围绕公司发展战略布局展开，将在现有存储芯片封装测试和模组制造业务基

础上增加新的产能，新增产能具备全球领先的技术水平，为公司产业转型升级奠定坚实的基础。

（二）公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司业务覆盖全球多个国家和地区，作为业务国际化的上市企业，公司已组建了具有国际化视野的高管团队和培养了经验丰富的生产管理人员及技术骨干，总结和开发了一套较为完善的人才管理及培养体系，为公司发展培育专业素质高、满足公司未来发展需求的储备人才，为项目的实施提供了有效的人力资源保障。此外，公司还将通过以下方式进一步加强人员培养与储备工作：

（1）全面贯彻和强化人才战略，采取积极的人才引进机制，大力引进有国际化企业工作经验和创新理念的综合型高端封装测试技术人才和经营管理人才，增强企业整体研发和管理实力。

（2）持续实施公司内部人才培养计划，根据公司制定的人才培养目标，在已有骨干和储备人才中通过业务培训等形式循序渐进、有计划地持续培养选拔，全面加强人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。

2、技术储备

本次实施的募投项目技术来源于沛顿科技的自主研发与长期积累，沛顿科技存储芯片封装制程采用的是当前高端产品的主流技术，如 wBGA、LGA、SOP、TSOP、QFN、系统级 Sip 封装技术等，现有产品已实现多达 16 层的多晶堆叠技术，最大单颗芯片容量可达到 256G。

沛顿科技具备 DDR4 封装和测试技术，采用的 BGA、LGA 等封装测试技术优势明显，产品合格率高，交货周期快，产品质量稳定，领先于国内其他竞争对手；沛顿科技的日本研发团队开发测试方案和程式，提供定制化服务的支持，技术工艺竞争优势明显。

公司强大的技术实力，可实现对客户不断变化的需求做出快速反应，在技术水平和综合效率方面始终处于行业领先地位，为本项目的实施提供了重要的技术保障。

3、市场储备

公司致力于为全球行业一流客户提供综合服务，集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供满足重点客户要求和市场发展需求的产品和服务，不断提升技术创新水平，加快发展步伐，建立双赢的战略合作关系，扩大产品市场占有率。通过本次募投项目的实施，公司将进一步推动自身向产业链高附加值的中上游存储芯片封装测试部分延伸，向核心技术领域的产业转型升级，提升综合服务客户的能力，巩固和提升已建立的战略合作伙伴关系。

本项目根据客户整体产能建设的需要，较好地契合客户业务布局，随着客户产能逐渐释放，将直接带动公司在集成电路封测业务订单的增加，为项目产能消化提供保障。

综上所述，公司具有较强的人员、技术及市场积累，具备实施本次募集资金投资项目的能力。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

（一）夯实公司主营业务基础，加大力度布局战略新兴产业

公司作为全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，在现有 EMS 核心业务基础上，通过自主创新与投资并购等方式，优化产业结构，加大力度布局高端集成电路封装测试等战略性新兴产业，力争实现经营业务的稳步增长。

在集成电路封装测试领域，公司拥有国内领先的封装和测试生产线和十多年量产经验，尤其在 DRAM 存储芯片方面具备世界最新一代的产品封测技术，既是国内最大的独立 DRAM 存储芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。公司积极寻求新兴产业成长机会，加大力度布局集成电路封装测试等战略新兴产业，以国家集成电路产业发展为契机，把握发展机遇发挥现有优势，持续发展先进封装测试技术，积极参与委外封装测试项目，力求在新一轮产业变革中构筑先发优势。

（二）加快募投项目实施进度，提高资金使用效率

公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来战略发展方向，具有

较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将不断优化业务结构，继续做强、做优、做大主营业务，增强公司核心竞争力以提高盈利能力。

本次发行的募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增加未来几年的股东回报，降低即期回报被摊薄的风险。

（三）加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。

同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。

（四）优化投资者回报机制

公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规章制度，并在《公司章程》《深圳长城开发科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》《深圳长城开发科技股份有限公司股东回报规划（2021-2023 年）》等文件中明确了分红规划。

本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的内容，结合公司经营情况，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

综上所述，公司将夯实公司主营业务基础，加大力度布局战略新兴产业，加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用，优化投资者回报机制，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

六、公司全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

7、自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。”

七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、如违反或未能履行上述承诺，控股股东、实际控制人中国电子信息产业集团有限公司同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关监管措施。”

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十七日